

## 2024年度 (2025年3月期) 決算説明会

2025/05/09

株式会社東京精密

代表取締役会長CEO 吉田 均

代表取締役社長COO 木村 龍一

代表取締役副社長CFO 川村 浩一

- ・ **将来の事象に係わる記述に関する注意：** 本資料に記載されている情報、ならびに口頭で提供される情報は、現時点で入手可能な情報をもとに、当社が合理的であると判断した一定の前提に基づいております。これらは、市況、競争状況、半導体業界、ならびに自動車関連業界等の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。従って、今後の当社の実際の業績が、本資料に記載されている情報と大きく異なる場合がありますことをご承知おき下さい。
- ・ **用語について：** 注記がある場合を除き、半導体製造装置セグメントを「半導体」、精密計測機器セグメントを「計測」、また親会社株主に帰属する当期純利益を「当期純利益」と記載します。
- ・ **記入データについて：** 記載されている金額や比率の情報は「億円」、またはパーセント(%)による要約表示を行っております。その為、内訳の計が合計と一致しない場合があります。
- ・ **監査について：** 本プレゼンテーション資料は、監査法人による監査の対象外です。

## エグゼクティブサマリー

<b>2024年度 業績</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>売上高1,505億円、純利益256億円となり、既往ピークを更新</li><li>生成AIを含むHPC及び、中国需要の受注・売上が進展、増収増益の着地</li><li>期末配当予想を修正、年間配当予想は253円(前期比61円増配)</li></ul>
<b>2025年度 業績予想</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>通期売上高予想 1,590億円、営業利益310億円、増収増益予想</li><li>民生需要の回復が見込みづらい中 引き続き生成AIを含むHPC等がけん引</li></ul>
<b>本日発表の 中期経営計画の ポイント</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>2025年度-2027年度 中期経営計画を策定</li><li>パーパス実現の一步として、成長とインフラ固めを両立させる</li><li>単年度定量目標：売上高1,850億円、営業利益450億円、ROE15%</li></ul>

- 代表取締役社長COOの木村です。  
本日はご多忙のところ、ご参加いただきまして 厚く御礼申し上げます。
- まず2ページ目は、本日の開示内容に関するエグゼクティブサマリーです。
- なお、今回の説明会より生成AIに関連するAIロジック、HBM、HPCを合わせて「生成AIを含むHPC」と呼称します。
- 2024年度業績ですが、売上高・純利益で既往ピークを更新しました。  
民生需要が軟調な中でも、生成AIを含むHPC向けの受注・売上が進展しました。  
また、本日の適時開示にありますように、  
期末配当予想を1株あたり25円増配することとしました。  
年間配当予想は、前期比 1株あたり61円増配の、1株253円となります。
- 2025年度業績予想ですが、売上高 1,590億円、営業利益310億円と、  
増収増益予想を開示しました。  
引き続き、民生需要の回復が見込みづらいものの、生成AIを含むHPCがけん引してゆく想定です。
- また、2025年度から2027年度までの中期経営計画を発表いたしました。  
当社のパーパスを実現するための長期ビジョンを踏まえ、期間の成長と、今後の成長の為にインフラ固めを両立させていく予定です。
- 中期経営計画の定量目標は、単年度の売上高1,850億円、営業利益450億円、ROE15%といたしました。

## 2024年度 通期連結業績

増収増益決算。連結売上高・純利益は既往ピークを更新。受注高も両セグメントで増加

全社業績(億円)	2023年度	2024年度	2月予想比	前期比	
受注高	1,209	1,456	-	+20%	
売上高	1,347	1,505	+45	+12%	
営業利益	253	297	+12	+17%	
(利益率)	(19%)	(20%)	-	+1pt	
経常利益	265	299	+14	+13%	
当期純利益	194	256	+23	+32%	
試験研究費	90	104	+9	+15%	
設備投資	116	102	+7	-12%	
減価償却費	47	51	-1	+9%	
セグメント別業績	2023年度	2024年度	2月予想比	前期比	
半導体 製造装置	受注高	861	1,077	-	+25%
	売上高	1,001	1,135	+30	+13%
	営業利益	199	243	-	+22%
	(利益率)	(20%)	(21%)	-	+2pt
計測機器	受注高	348	379	-	+9%
	売上高	346	371	+16	+7%
	営業利益	54	54	-	-0%
	(利益率)	(16%)	(15%)	-	-1pt

- 3ページは、2024年度通期の業績です。
- 上段、2024年度は、受注高1,456億円、売上高 1,505億円、営業利益297億円、経常利益299億円、当期純利益256億円となり、売上高は初めて1,500億円を超えたほか、純利益は既往ピークを更新しました。
- 中段、試験研究費の実績は104億円、設備投資は102億円、減価償却費は51億円となりました。  
試験研究費は、開発の強化、  
設備投資は、新たに決定した韓国でのデモセンター建設投資などにより、予定を上回る規模となりました。
- セグメント別の業績は下段の通りです。
- また 本日 配当に関する適時開示を行っております。  
期末配当予想を1株あたり139円とし、  
年間配当の予想は、1株253円となります。

## 2024年度 第4四半期 連結業績

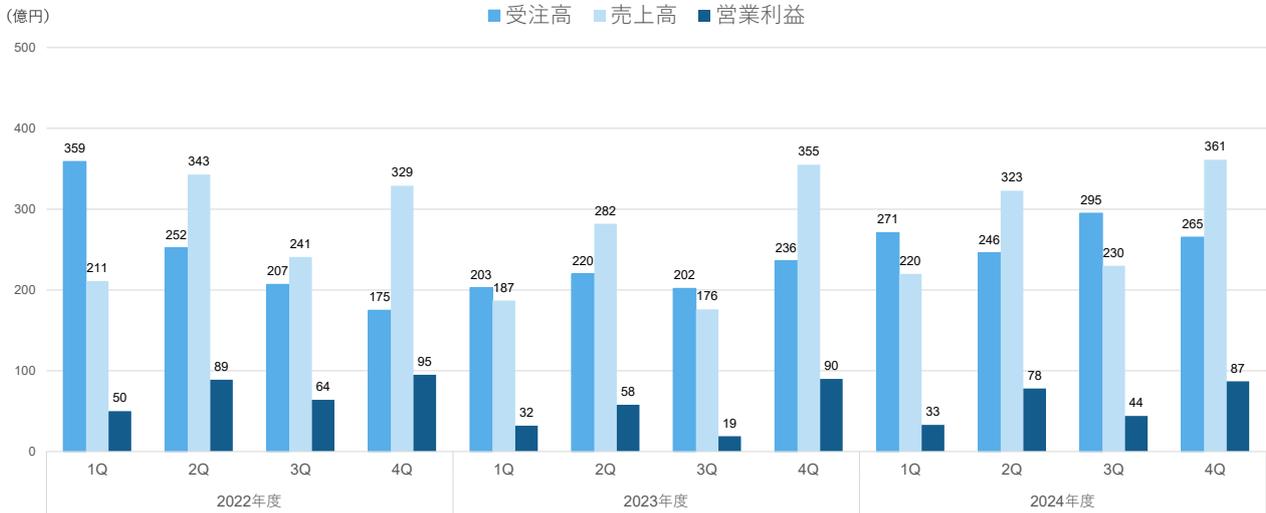
第4四半期の売上高は高水準・前年同期比で増加

全社業績(億円)	2023-1Q	2023-2Q	2023-3Q	2023-4Q	2024-1Q	2024-2Q	2024-3Q	2024-4Q	前四半期比	前年同期比	
受注高	295	299	301	312	374	337	392	353	-10%	+13%	
売上高	266	369	254	458	296	418	317	474	+50%	+4%	
営業利益	43	71	30	109	41	93	57	106	+87%	-3%	
(利益率)	(16%)	(19%)	(12%)	(24%)	(14%)	(22%)	(18%)	(22%)	+5pt	-2pt	
経常利益	47	74	30	114	43	88	66	101	+53%	-11%	
当期純利益	32	53	21	88	36	100	46	75	+64%	-14%	
試験研究費	22	23	23	22	23	28	25	28	+8%	+25%	
設備投資	48	19	13	35	28	12	24	39	+60%	+9%	
減価償却費	10	11	13	13	12	13	13	13	+3%	+2%	
セグメント別業績	2023-1Q	2023-2Q	2023-3Q	2023-4Q	2024-1Q	2024-2Q	2024-3Q	2024-4Q	前四半期比	前年同期比	
半導体 製造装置	受注高	203	220	202	236	271	246	295	265	-10%	+12%
	売上高	187	282	176	355	220	323	230	361	+57%	+2%
	営業利益	32	58	19	90	33	78	44	87	+96%	-3%
	(利益率)	(17%)	(20%)	(11%)	(25%)	(15%)	(24%)	(19%)	(24%)	+5pt	-1pt
計測機器	受注高	92	80	100	76	103	91	98	87	-11%	+14%
	売上高	79	87	78	103	76	95	87	113	+30%	+10%
	営業利益	10	14	11	19	8	15	12	19	+56%	-1%
	(利益率)	(13%)	(16%)	(14%)	(19%)	(10%)	(16%)	(14%)	(17%)	+3pt	-2pt

- 4ページは、四半期の業績推移となります。
- この第4四半期ですが、両セグメントとも出荷が想定以上に進んだことで、前四半期比で増収となり利益も増加しました。
- 受注高は、両セグメントとも、前四半期比で減少しておりますが、引き続き高水準となっております。
- 次に、セグメント別に説明いたします。

## 半導体製造装置セグメント 業績推移

第4四半期の受注高は、引き続き生成AIを含むHPC需要がけん引も、受注残高の一部整理(約20億円)により前四半期比で減少



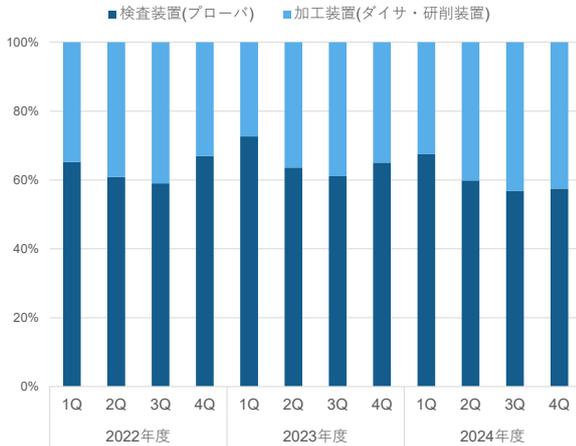
- 5ページは、半導体の受注高・売上高・営業利益の四半期推移をグラフで示したものです。
- この第4四半期の受注高は265億円となりました。  
生成AIを含むHPC関連の受注は、当社の想定を上振れた一方、売上の実現性が低いと判断した受注残高を約20億円整理した結果、前四半期比では減少しました。  
なお、第3、第4四半期、すなわち下期の受注高に占める生成AIを含むHPCの受注構成比は、3割半ばとなりました。
- 第4四半期の売上高は、出荷が想定以上に進み、大幅に増加しました。  
なお、下期の生成AIを含むHPCの売上構成比は、約2割でした。

## 半導体製造装置セグメント 製品別構成比

第4四半期はプローバの受注構成比が増加

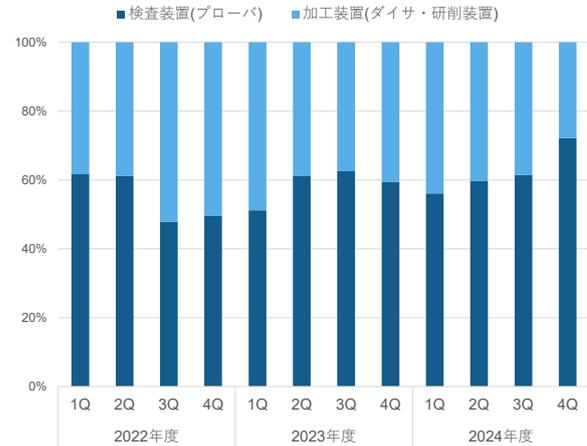
(億円)

<売上高>



(億円)

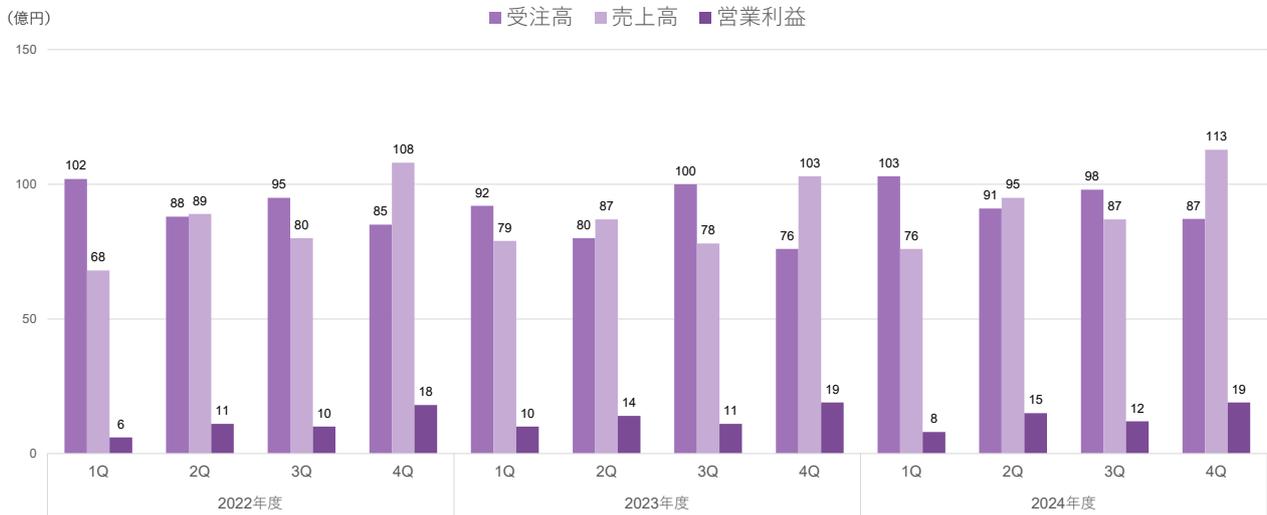
<受注高>



- 6ページは、半導体の四半期受注高・売上高を装置別に示したものです。
- 右側、受注高について、第4四半期の検査装置、プローバの受注構成比が従前の6割程度から、7割程度まで上昇しています。  
これは、高精度温度制御のプローバの受注が増加している一方で、SiC向けのグラインダ需要が減少していることなどによります。

## 計測機器セグメント 業績推移

第4四半期の受注高は、季節的な減少の中、更新需要などの獲得により一定の水準



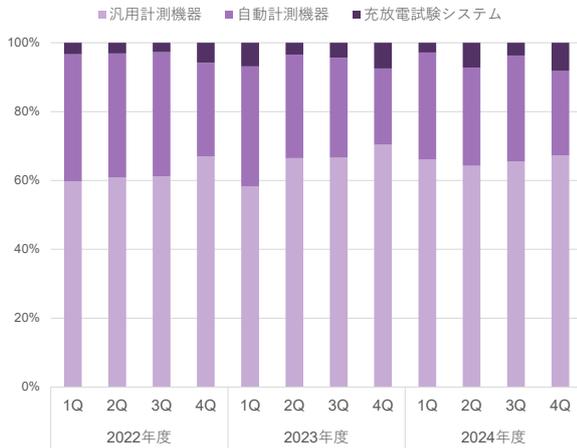
- 7ページは、計測の受注高・売上高・営業利益の四半期推移をグラフで示したものです。
- 第4四半期の受注高は87億円となりました。季節的な減少はありましたが、設備更新需要などを獲得し、一定の水準となりました。

## 計測機器セグメント 製品別構成比

第4四半期は受注・売上ともに製品別構成比に大きな変化はない

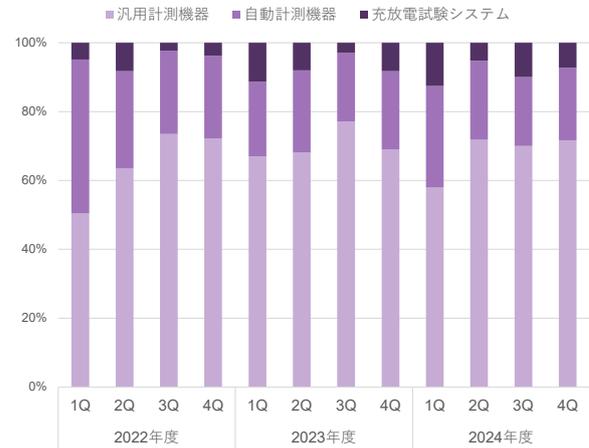
(億円)

<売上高>



(億円)

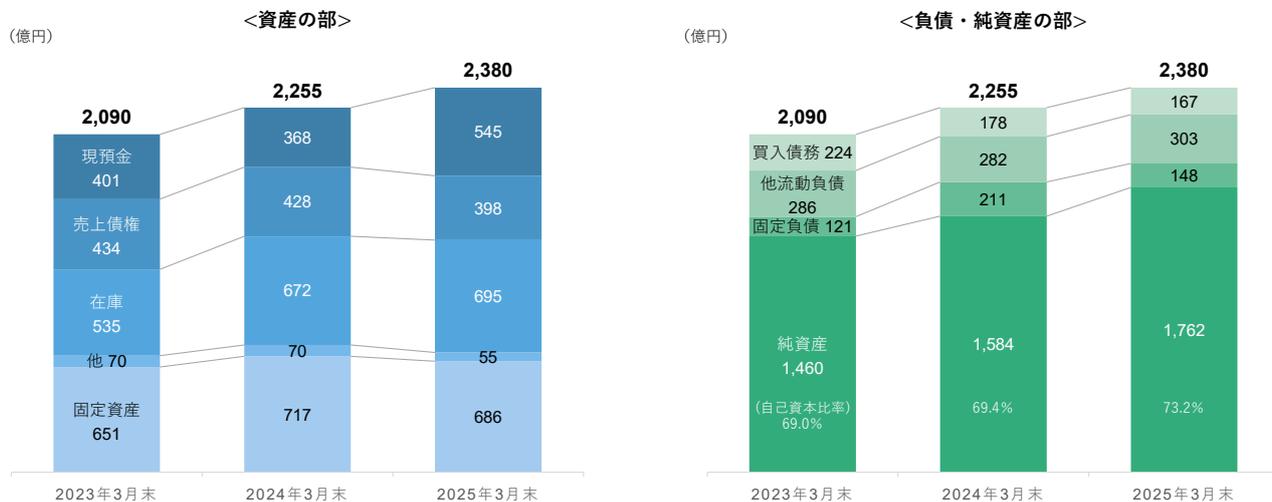
<受注高>



- 8ページは、計測の四半期受注高・売上高を装置別に示したものです。
- 装置別の受注動向は、多少のばらつきがございますが、充放電試験システムの受注構成比が増加傾向となっています。

## 貸借対照表

売上債権の回収・固定資産の譲渡等により現預金が増加、長期借入金が減少

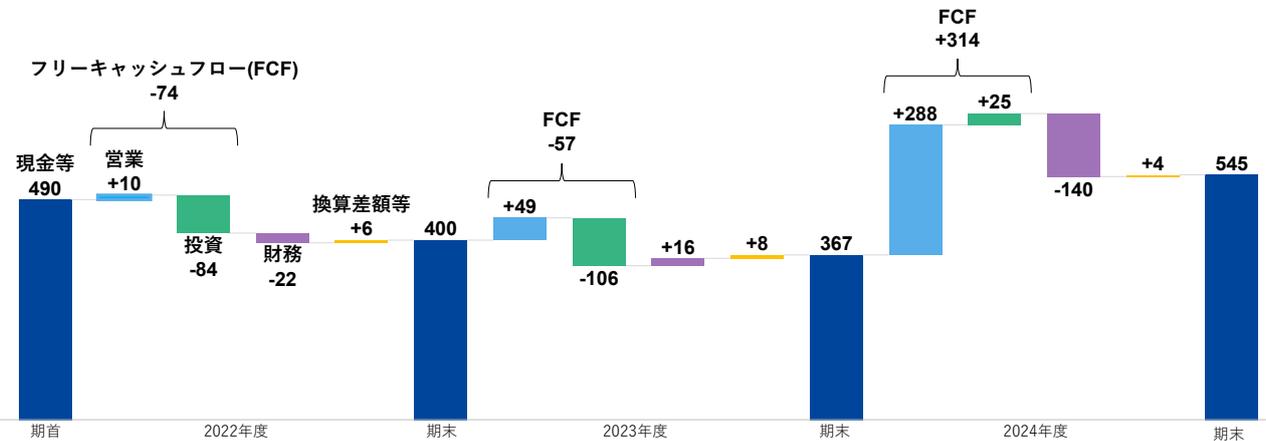


- 9ページは貸借対照表の説明です。
- 2025年3月末の総資産は、2,380億円となりました。
- 左側、資産の部ですが、売上債権の回収や固定資産の売却により、現預金が増加しました。在庫については、引き続き将来の出荷を見据えた水準となっています。
- 右側、負債・純資産の部については、長期借入金が減少したことで、負債が減少、利益の計上により純資産が増加しました。
- 3月末の自己資本比率は73.2%となりました。

## キャッシュフロー

利益の増加、売上債権の回収、固定資産売却などにより、FCFは3期ぶりのプラス

(億円)



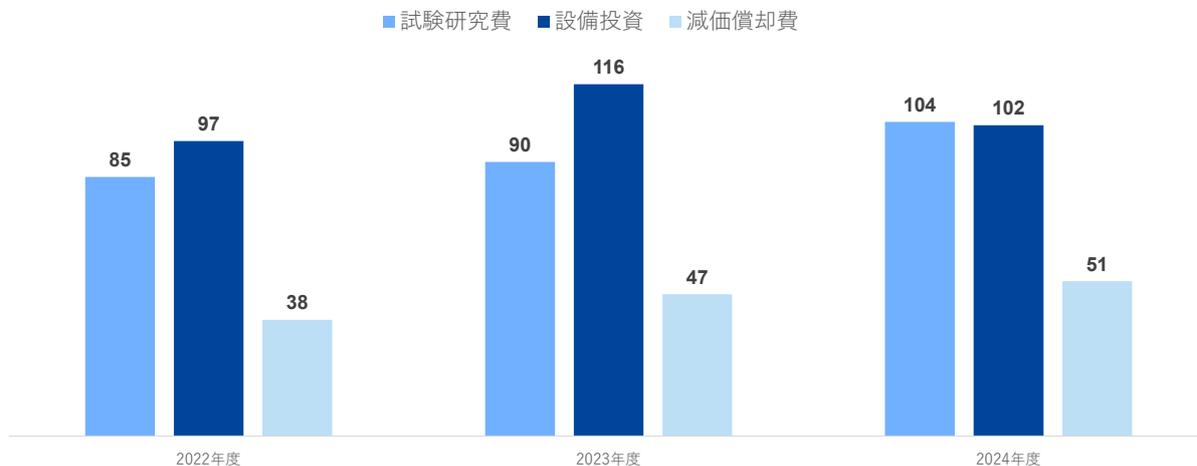
- 10ページはキャッシュフローに関する説明です。右側が2024年度です。
- 今年度のフリーキャッシュフローはプラス314億円となり、3期ぶりのプラスとなりました。
- この2か年は、将来の売上に向けた在庫増、設備投資などによりフリーキャッシュフローがマイナスでしたが、その在庫増加傾向が落ち着いてきたこと、売上債権回収や固定資産の売却により、プラスに転じました。
- 期末の現預金残高は545億円となりました。

## 試験研究費・設備投資・減価償却費

研究開発活動の強化により 試験研究費が増加

設備投資として、名古屋工場建設のほか、韓国デモセンター新規着工に向けた設備投資が発生

(億円)



- 11ページは試験研究費、設備投資、減価償却の実績です。
- 2024年度は、より一層研究開発活動を強化したことにより研究開発費が100億円を超える水準となりました。
- 設備投資ですが、今年7月に竣工予定の名古屋工場の投資に加え、この度 韓国に新たなデモセンターを建設することを決定しました。この投資が2024年度に20億円程度追加で発生したことで、計画を上回りました。
- 減価償却費はほぼ想定並みの着地でした。
- ここまでが、2024年度実績の説明となります。

## 2025年度通期業績予想の前提

### 売上・営業利益

関税政策の影響：動向を注視

半導体：引き続き生成AIを含むHPC案件の売上が貢献

- 生成AIを含むHPC：売上高・利益に占める割合は増加(3割程度)
- グローバルOSAT：HPC向けプローバの出荷増加を想定
- 中国需要：受注済案件の出荷・据付が計画通り続く

計測：汎用・自動計測は回復が待たれる、下期以降は充放電試験システムの売上が貢献

利益：部材調達価格・経費等の上昇が見込まれるが、原価低減活動を進める

### 受注動向

関税政策の影響：動向を注視

半導体：投資判断に一時的な停滞傾向がみられるが、生成AIを含むHPC需要は堅調と想定

- 生成AIを含むHPC：2025年度上期は2024年度下期の力強さを維持
- グローバルOSAT：稼働率は回復傾向。China +1 需要を含む投資拡大に期待
- 中国需要：パワー半導体を除き、一定の水準で推移

計測：引き続き、更新投資や充放電試験システムの事業機会を捉える

- 12ページには、2025年度の通期業績予想の前提を示しております。
- まず、売上・利益面です。  
関税政策の影響については、状況を注視しておりますが、定量的に見積もることは困難であり、予想には折り込んでおりません。その上で、売上面では前期から続く生成AIを含むHPCの出荷、ならびにグローバルOSAT向けの売上が貢献するほか、中国向けの出荷・据付も堅調と想定しています。計測では、汎用・自動計測の需要回復が待たれますが、下期以降、充放電試験システムの売上増加を想定しています。利益面では、経費などの上昇を抑制しながら原価低減を図り、一定の利益率を確保していきます。
- 受注動向についてです。  
関税政策の影響により、顧客が一時的に投資判断を延伸する可能性があります。これが全体に及ぼす影響は想定が難しく、動向を注視しています。その上で、生成AIを含むHPCに関連した引合いは、2024年度下期の勢いを維持すると見ています。また、グローバルOSATの稼働率も回復傾向にあり、さらにAIの民生エレクトロニクスへの普及による需要の回復に強く期待をしております。

## 2025年度通期業績予想

半導体は、引き続き生成AIを含むHPCがけん引、計測は、事業環境に大きな変化はない想定

設備投資は、東京都八王子市に新工場向け用地を取得

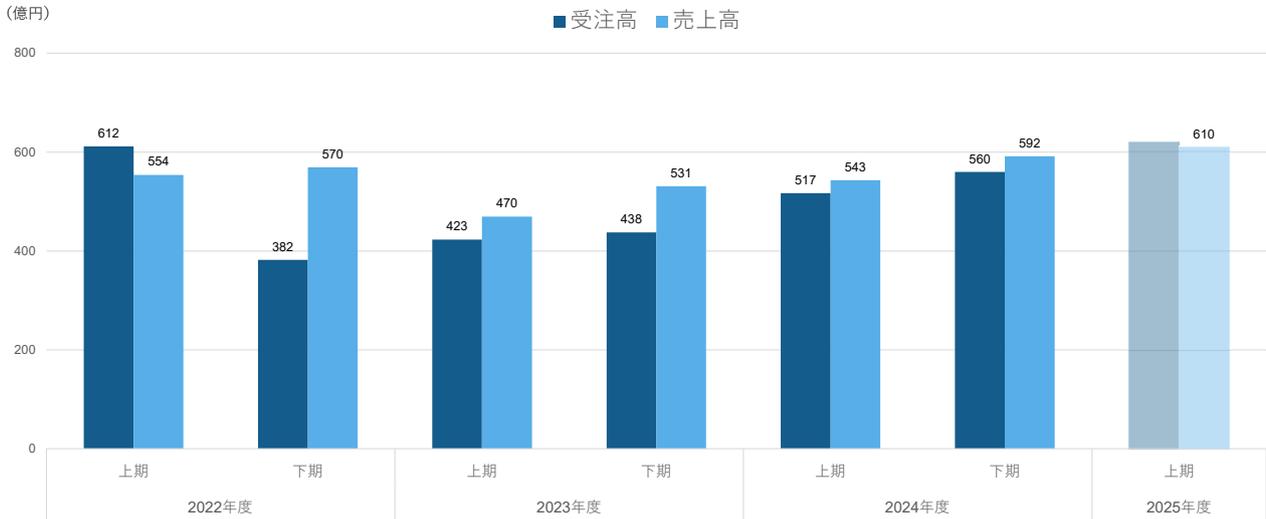
前提為替レートは140円/ドル（為替変動影響は軽微：円建て比率高）

全社業績(億円)	2024年度 上期	2024年度 下期	2024年度通期	2025年度 上期予	2025年度 下期予	2025年度通期予	前期比
受注高	711	745	1,456	-	-	-	-
売上高	714	791	1,505	785	805	1,590	+6%
営業利益	134	163	297	152	158	310	+4%
(利益率)	(19%)	(21%)	(20%)	(19%)	(20%)	(20%)	-0pt
経常利益	132	168	299	152	158	310	+4%
当期純利益	136	121	256	106	111	217	-15%
試験研究費	51	53	104	-	-	115	+11%
設備投資	40	63	102	-	-	110	+7%
減価償却費	25	26	51	-	-	55	+8%
セグメント売上高	2024年度 上期	2024年度 下期	2024年度通期	2025年度 上期予	2025年度 下期予	2025年度通期予	前期比
半導体製造装置	543	592	1,135	610	610	1,220	+8%
計測機器	171	199	371	175	195	370	-0%

- これらの前提を踏まえた2025年度の通期業績予想を13ページに記載しています。
- 売上高 1,590億円、営業利益310億円、経常利益310億円、当期純利益217億円を見込んでおります。
- セグメント別の売上予想は、半導体1,220億円、計測370億円としています。
- 2025年度の設備投資には、東京都八王子市に新設する工場の用地取得が含まれます。
- 前提為替レートは、1ドルが140円です。  
現時点では、為替変動による業績への変動は軽微と見積もっております。
- なお配当については、1株214円を予想しています。

## 半導体 - 売上・受注高 見込

2025年度上期受注高は前年度下期比で10%増加を想定



- 14ページは、半導体事業の売上高及び受注高の、半期ごとの見込みです。
- この上期の受注高は、前年度下期比 約10%の増加を想定しています。
- 上期予想の製品構成比は、  
売上高、受注高ともに、検査装置 6割、加工装置4割を想定しています。
- また、上期の生成AIを含むHPCの構成比は  
受注高で3割、売上高で2割半ばを見積もっております。

## 計測 - 売上・受注高 見込

2025年度上期受注高は前年度下期比で微増を想定



- 15ページは、計測事業の売上高及び受注高の、半期ごとの見込みです。
- 上期の受注は、前年度下期比で微増を想定しております。  
新規投資が伸び悩む中でも、幅広く更新需要を積み上げていく計画です。
- 上期予想の製品構成比は、  
売上高、受注高ともに、汎用計測 6割、自動計測が3割、  
残りが充放電を想定しています。
- 以上が、2024年度決算、ならびに2025年度業績の説明となります。  
ご清聴 ありがとうございました。

## 質疑応答 / Q&A

## Supplementary Data - セグメント別業績推移 / Segment Information

(百万円) Million Yen	会計期間 Fiscal Year				四半期 Quarter								
	2022年 3月期 FY2022/3	2023年 3月期 FY2023/3	2024年 3月期 FY2024/3	2025年 3月期 FY2025/3	2024年3月期 FY2024/3				2025年3月期 FY2025/3				
					1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	
Orders 受注総額	半導体 SPE	152,896	99,366	86,082	107,713	20,345	21,957	20,175	23,604	27,081	24,631	29,456	26,544
	計測 Metr.	33,159	36,960	34,802	37,917	9,225	7,981	9,963	7,632	10,336	9,082	9,781	8,717
	合計 Total	186,056	136,326	120,885	145,631	29,571	29,938	30,139	31,236	37,417	33,713	39,237	35,262
Backlog 受注総残	半導体 SPE	102,370	89,371	75,398	69,630	90,993	84,710	87,300	75,398	80,433	72,785	79,205	69,630
	計測 Metr.	9,904	12,428	12,606	13,470	13,758	13,061	15,253	12,606	15,362	14,911	16,031	13,470
	合計 Total	112,274	101,799	88,004	83,101	104,752	97,771	102,553	88,004	95,796	87,697	95,236	83,101
Sales 売上総額	半導体 SPE	101,145	112,365	100,055	113,481	18,722	28,241	17,585	35,505	22,046	32,280	23,036	36,118
	計測 Metr.	29,556	34,436	34,624	37,053	7,895	8,678	7,772	10,278	7,580	9,532	8,661	11,278
	合計 Total	130,702	146,801	134,680	150,534	26,618	36,919	25,357	45,784	29,626	41,812	31,698	47,397
OP 営業利益	半導体 SPE	24,698	29,866	19,899	24,311	3,208	5,773	1,912	9,004	3,314	7,824	4,449	8,722
	計測 Metr.	3,628	4,628	5,408	5,392	1,042	1,365	1,084	1,916	768	1,497	1,220	1,905
	合計 Total	28,327	34,494	25,307	29,703	4,250	7,138	2,997	10,921	4,083	9,322	5,670	10,627
OP Margin 営業利益率	半導体 SPE	24.4%	26.6%	19.9%	21.4%	17.1%	20.4%	10.9%	25.4%	15.0%	24.2%	19.3%	24.1%
	計測 Metr.	12.3%	13.4%	15.6%	14.6%	13.2%	15.7%	14.0%	18.6%	10.1%	15.7%	14.1%	16.9%
	合計 Total	21.7%	23.5%	18.8%	19.7%	16.0%	19.3%	11.8%	23.9%	13.8%	22.3%	17.9%	22.4%

## Supplementary Data - 損益計算書 / Income Statement

(百万円) Million Yen	会計期間 Fiscal Year				四半期 Quarter							
	2022年 3月期 FY2022/3	2023年 3月期 FY2023/3	2024年 3月期 FY2024/3	2025年 3月期 FY2025/3	2024年3月期 FY2024/3				2025年3月期 FY2025/3			
					1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
売上高 Net Sales	130,702	146,801	134,680	150,534	26,618	36,919	25,357	45,784	29,626	41,812	31,698	47,397
売上原価 Cost of goods sold	77,694	84,967	79,917	88,081	15,415	22,387	14,894	27,220	17,753	24,757	17,960	27,609
売上総利益 Gross Profit on Sales	53,008	61,834	54,762	62,453	11,203	14,531	10,462	18,564	11,873	17,054	13,738	19,787
販売費および一般管理費 Selling, general and administrative expenses	24,681	27,339	29,454	32,750	6,952	7,392	7,465	7,643	7,790	7,732	8,067	9,159
営業利益 Operating profit	28,327	34,494	25,307	29,703	4,250	7,138	2,997	10,921	4,083	9,322	5,670	10,627
営業外収益 Non-operating income	987	965	1,404	921	563	245	52	541	287	39	539	55
営業外費用 Non-operating expenses	153	162	259	684	103	22	64	67	41	531	-422	534
経常利益 Recurring Profit	29,160	35,297	26,453	29,939	4,710	7,361	2,985	11,394	4,329	8,829	6,632	10,148
特別利益 Extraordinary gains	390	103	824	4,493	26	-	3	794	10	4,483	0	0
特別損失 Extraordinary losses	34	2,099	21	158	-	14	-	7	-	-	157	0
税引前利益 Profit before income taxes and minority interests	29,516	33,301	27,255	34,275	4,736	7,347	2,989	12,181	4,339	13,312	6,474	10,148
法人税等合計 Total income tax and others	8,132	9,607	7,791	8,531	1,456	1,998	897	3,437	754	3,310	1,870	2,596
非支配株主に帰属する四半期純利益 Net Profit attributable to minority interests	57	62	84	106	33	46	24	-19	31	6	29	39
親会社株主に帰属する当期純利益 Net Profit attributable to Owners of the Parent	21,326	23,630	19,378	25,637	3,245	5,302	2,067	8,763	3,554	9,996	4,574	7,512
1株当たり当期純利益(円) Net Profit per Share (Yen)	522.52	581.33	480.49	633.75	80.63	131.49	51.23	217.00	87.89	247.09	113.07	185.67
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益(円) Net Profit per Share (diluted) (Yen)	517.51	575.62	475.42	628.31	-	-	-	-	-	-	-	-

## Supplementary Data - 貸借対照表 / Balance Sheet

(百万円) (Million Yen)		2022年3月期 FY2022/3	2023年3月期FY2023/3	2024年3月期 FY2024/3	2025年3月期 FY2025/3
流動資産 Current Assets	現金及び預金 Cash and cash equivalents	49,033	40,080	36,782	54,541
	売上債権※1 Accounts Receivable※1	38,367	43,403	42,801	39,809
	在庫 Inventories	40,325	53,482	67,225	69,513
	その他 Others	6,103	7,005	7,022	5,477
	合計 Total	133,829	143,972	153,831	169,341
固定資産合計 Total Fixed Assets	56,457	65,060	71,693	68,610	
総資産 Total Assets	190,287	209,032	225,524	237,952	
流動負債 Current Liabilities	買入債務※2 Accounts Payable※2	29,876	22,359	17,845	16,665
	その他 Others	25,765	28,588	28,156	30,268
	合計 Total	55,641	50,947	46,002	46,933
固定負債合計 Total long-term liabilities	3,564	12,057	21,094	14,789	
負債合計 Total Liabilities	59,206	63,004	67,097	61,723	
純資産合計 Total Net Assets	131,081	146,028	158,427	176,229	
負債・純資産合計 Total Liabilities and Net Assets	190,287	209,032	225,524	237,952	
有利子負債合計 Total interest-bearing debt	5,497	14,191	25,171	20,084	
自己資本比率 Equity Ratio(%)	68.1%	69.0%	69.4%	73.2%	
自己資本利益率 ROE(%)	17.4%	17.3%	12.9%	15.5%	

※1: 電子記録債権、契約資産を含む  
Incl. Electronically recorded monetary claims

※2: 電子記録債務を含む  
Incl. Electronically recorded obligations-operating

## Supplementary Data - 各種費用, キャッシュフロー/ Expenses and Cash

(百万円) (Million Yen)	2022年3月期 FY2022/3	2023年3月期 FY2023/3	2024年3月期 FY2024/3	2025年3月期 FY2025/3
試験研究費 R&D expenses	8,146	8,542	9,042	10,354
設備投資 Capex	9,793	9,725	11,602	10,245
減価償却費 (のれんの償却を除く) Depreciation (excl. Amortization of goodwill)	3,551	3,832	4,673	5,105

(百万円) (Million Yen)	2022年3月期 FY2022/3	2023年3月期 FY2023/3	2024年3月期 FY2024/3	2025年3月期 FY2025/3
営業活動によるキャッシュフロー Cash flows from operating activities	23,837	1,000	4,892	28,824
投資活動によるキャッシュフロー Cash flows from investing activities	-8,990	-8,421	-10,563	2,541
フリーキャッシュフロー Free cash flows	14,846	-7,421	-5,671	31,365
財務活動によるキャッシュフロー Cash flows from financing activities	-10,346	-2,174	1,616	-13,991
現金及び現金同等物に係る換算差額等 Adjustments	882	625	755	404
現金及び現金同等物の期末残高 Cash and cash equivalents at the end of year	49,006	40,036	36,736	54,516

(人数) (# of People)	2022年3月期 FY2022/3	2023年3月期 FY2023/3	2024年3月期 FY2024/3	2025年3月期 FY2025/3
正社員合計 Total regular employees	2,354	2,468	2,658	2,767
臨時従業員 年間平均雇用人員数 (*1) Average number of part-time employees, not included in the above figure	1,123	1,258	1,225	1,258
従業員合計 (*1) Number of employees	3,477	3,726	3,883	4,025